

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 25 年 2 月 7 日 (2013.2.7)

【公表番号】特表 2010-507260 (P2010-507260A)  
 【公表日】平成 22 年 3 月 4 日 (2010.3.4)  
 【年通号数】公開・登録公報 2010-009  
 【出願番号】特願 2009-533462 (P2009-533462)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 21/768 (2006.01)

H 0 1 L 23/522 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/88 J

【誤訳訂正書】  
 【提出日】平成 24 年 12 月 7 日 (2012.12.7)  
 【誤訳訂正 1】  
 【訂正対象書類名】明細書  
 【訂正対象項目名】0 0 4 3  
 【訂正方法】変更  
 【訂正の内容】  
 【0 0 4 3】

この時点で、本手法により、二つの新規オプションが利用可能になる。一つのオプションでは、図 3 I に示すように、ウエハ 3 0 0 をダイシングして、そのチップを薄くして新規に形成される接点 3 2 6、3 2 8 を露出させるか、またはウエハ 3 0 0 を薄くしてからダイシングすることができる。どちらの場合でもその後、要望または必要があれば、例えば、接点パッド 3 3 0、3 3 2 を作成する（図 3 J）。他のオプションでは、例えば、全体的なパイアのピッチや第 2 の溝が適切なサイズと空間であるのとは対照的に、非常に細かいパイアを必要とする理由が接続されるポイントに関係している場合、ウエハまたは（ダイシングされている場合は）チップは、第 2 パイアまで簡単に薄くすることができる（図 3 K）。その後、図 3 L に示すように、接点パッド形成プロセスの前に、またはそのプロセスの一部として、第 2 パイアを導体 3 3 4 で充填することができる。この方法で、ウエハまたはチップをより厚く維持することができる。